金亚科技股份有限公司

关于公司收到法院传票的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次诉讼事项的基本情况

金亚科技股份有限公司(以下简称: "公司"或"金亚科技")向成都市金 牛区人民法院(以下简称:"法院")提起诉讼,请求北京华创信通科技有限公 司向公司支付货款及违约金等款项。公司于近日收到了法院发来的传票及相关法 律文书。根据所收到的法律文书显示, 法院将于 2020 年 4 月 28 日对前述买卖合 同纠纷案进行一审开庭。

二、本案的基本情况:

(一)诉讼各方当事人

原告: 金亚科技股份有限公司

被告: 北京华创信通科技有限公司

(二) 主要事实与理由

2016年1月8日,原告与被告签订《框架合作协议》,约定由原告依照被告 的订货要求向被告供应产品。协议签订后,原告依约履行了供货义务。原被告双 方分别于 2016 年 10 月以及 2017 年 2 月进行了对账, 共同确认被告未支付货款 总额为 3,425,050.5 元。对账完成后,原告分别于 2017 年 5 月 2 日及 2017 年 10月27日向被告发送催款函,要求被告支付货款3,425,050.5及逾期付款违约 金。截至本公告披露日,被告仍未足额履行付款义务。原告认为被告迟延付款的 行为严重损害了原告的合同权益,其应当依法继续履行并支付违约金。

(三) 诉讼请求

请求判令被告向原告支付货款 3,425,050.5 元及逾期付款违约金请求判令被告承担本案的全部费用(包括但不限于诉讼费、保全费等)

三、判决或裁决情况

截至本公告披露日,本次诉讼尚未判决。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

由于本案尚未开庭审理,且未来的生效判决结果尚无法定论,其影响暂无法准确估计。公司会及时披露上述事项的进展情况,请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

金亚科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十四日